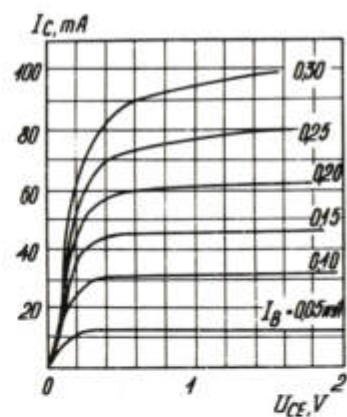
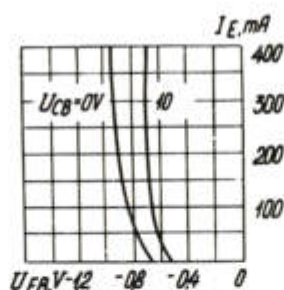
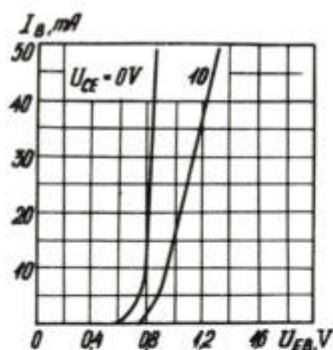


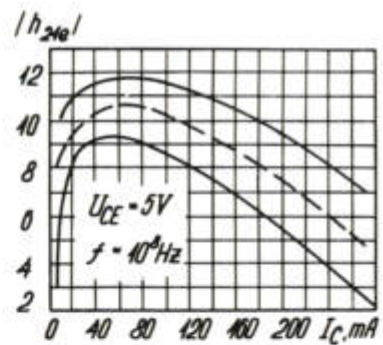
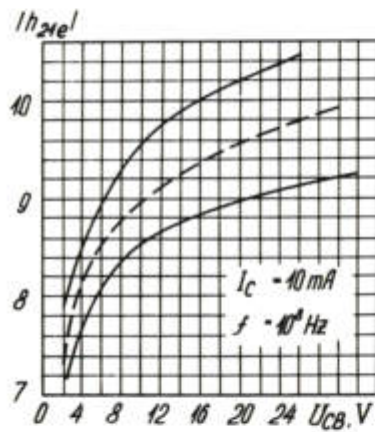
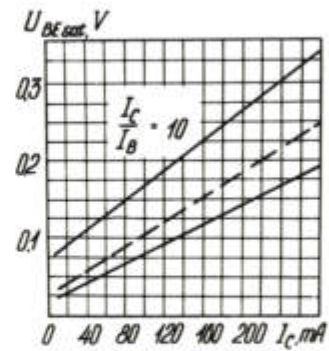
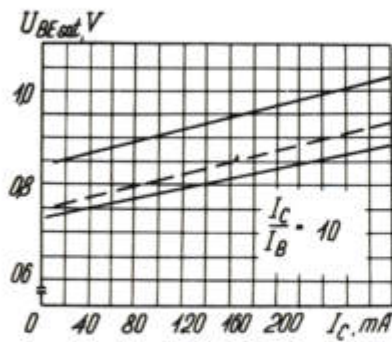
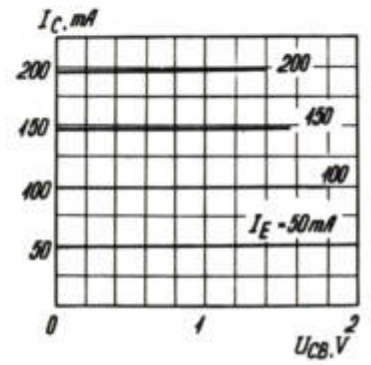
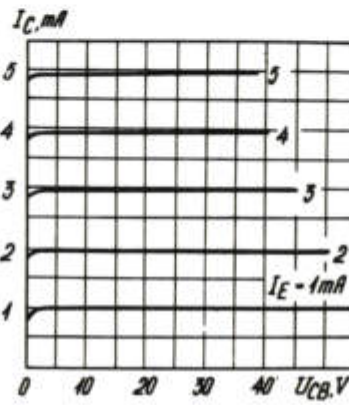
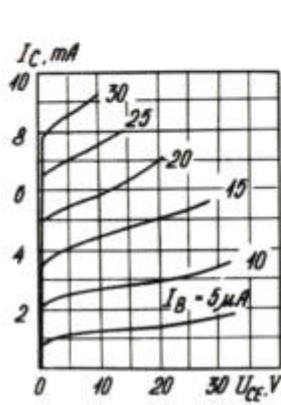
КТ3153А9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions		
		$U_{CB}; U_{EB}^{\times}; U_{CE}^{\times\times}$, V	$I_C; I_E^{\times}; I_B^{\times\times}$, mA	f , Hz
$U_{(L)CEO}$, V	> 32		$10^{\times}; 0^{\times\times}$	
I_{CBO} , nA	≤ 50	45		
h_{21E}	100 - 300	5	$2^{\times}$	50
$ h_{21e} $	$> 2,5$	$5^{\times\times}$	10	10^8
$U_{BE\text{ sat}}$, V	$\leq 0,85$		$10; 1^{\times\times}$	
$U_{CE\text{ sat}}$, V	$\leq 0,35$		$10; 1^{\times\times}$	
C_c , pF	$\leq 4,5$	10		10^7
C_e , pF	≤ 15	$0^{\times}$		10^7
t_s , ns	≤ 400		$10; 1^{\times\times}$	



KT3153A9

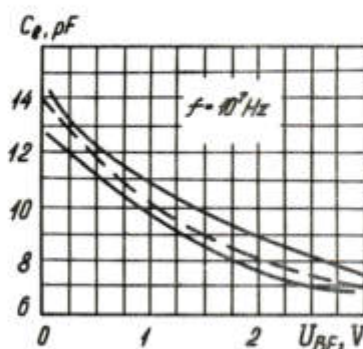
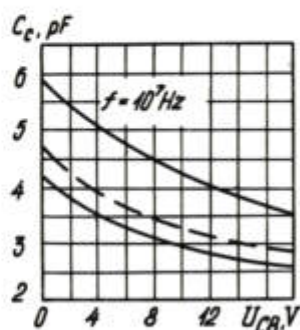
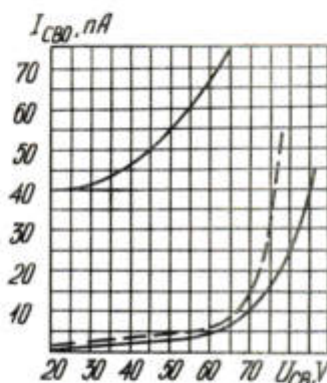
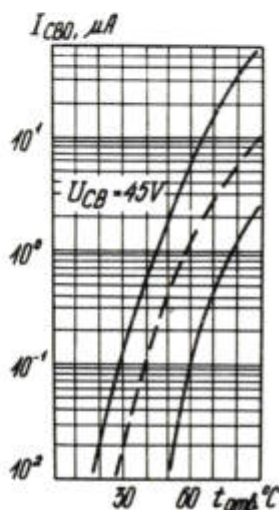


ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF 95% РАЗБРОСА
SPREAD

KT3153A9



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев на расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзистора. Время пайки 4 с при температуре не более 265°C.

Допускается отклонение от основных режимов и предлагаемого метода пайки при условии сохранения целостности конструкции и надежности транзисторов, что подтверждается проведением ресурсных испытаний.

OPERATING INSTRUCTIONS

Lead soldering is to be performed at a distance of > 0.15 mm from the transistors case. Tinning pastes and solders are recommended to be used.

Soldering time and temperature must not exceed 4 s and 260°C, respectively.

Basic technologies and the method applied can be modified provided the structure integrity and device reliability are maintained that must be proved by resource tests.



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95** / **0** РАЗБРОСА
SPREAD